

# OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Der Unterschied liegt im Detail



	zusätzliche Regalböden	Trennelemente	SMD Rollenhalter	SMD Rollenhalter ausziehbar	Rollenhalter auf ausziehbaren Regalböden	externe Alarmleuchte	höhenverstellbare Füße	ESD Rollen	manuelle / autom. Stickstoffeinheit	Feeder system ausziehbar	Heizung 40°/60°C	Wabenmodell für Stangenware, auch mit optischer Positionsanzeige	Feederhalter	Datenlogger SDDL und Software
SDB 151-40	lackiert	•	•				•		•/o		•/o			•
SDB 1104-40	lackiert	•	•	•			•	•	•/o		•/o	•	•	•
SDB 1106-40	lackiert	•	•	•			•	•	•/o		•/o		•	•
SD 151-21	Chromstahl	•	•			•	•		•/•		•/o			•
SD 302-21	Chromstahl	•	•			•	•		•/•		•/o			•
SD 502-21	Chromstahl	•	•			•	•		•/•					•
SD 702-21	Chromstahl	•	•			•	•	•	•/•				•	•
SD 1104-21	Chromstahl	•	•	•		•	•	•	o/•		•/o	•	•	•
SD 1106-21	Chromstahl	•	•	•		•	•	•	o/•		•/o		•	•
SD 1704-21	Chromstahl	•	•			•	•	•	o/•	•	•/o	•	•	•
SD+ 302-22	Chromstahl	•	•			•	•	•	•/•		•/o		•	••
SD+ 1104-22	Chromstahl	•	•	•		•	•	•	o/•		•/o	•	•	••
SD+ 1106-22	Chromstahl	•	•	•		•	•	•	o/•		•/o		•	••
HSD 1104-52	Chromstahl	•	•	•		•	•	•	o/•		•/o	•	•	••
HSD 1106-52	Chromstahl	•	•	•		•	•	•	o/•		•/o		•	••
HSD 1704-52	Chromstahl	•	•			•	•	•	o/•	•	•/o	•	•	••
MSD 1222-54	lackiert/ Chromstahl	•	•		•	•	••		o/•		•/o	•	•	••
MSD 1223-00	lackiert/ Chromstahl	•	•		•		••				•/o	•	•	
XSDB 701-54	Chromstahl		•		•	•	••	•	o/•		••/•	•	•	••
XSDB 1412-54	Chromstahl		•		•	•	••	•	o/•		••/•	•	•	••
XSD 701-54	Chromstahl		•		•	•	••	•	o/•		••/••	•	•	••
XSD 1412-54	Chromstahl		•		•	•	••	•	o/•		••/••	•	•	••
XSDV	lackiert/ Chromstahl	•	•	•	•	•	••	•	o/•	•	•/•	•	•	••
XSDC 601-01	Coated		•				••	•						•
XSDC 601-02	Coated		•				••	•						••
XSDC 1412-54	Stainless steel	•	•	•	•	•	••	•	o/•	•	•/•	•		••
XSDR	Stainless steel		•		•	•	••	•			••/••			••

• optional

•• serienmäßig

o nicht lieferbar

## REFERENZTABELLE

Unsere Referenztable bietet Ihnen einen Überblick über die Trocknungszeiten Ihrer Bauteile in Abhängigkeit von: Bauteilstärke, MSL Level, Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau.

Gehäusekörper	Klasse	Trocknung bei 60 °C + 5/-0 °C ≤ 1% RH		Trocknung bei 40 °C + 5/-0 °C ≤ 1%RH		Trocknung bei 25 °C + 5/-0 °C ≤ 1% RH		Trocknung bei 40 °C + 5/-0 °C ≤ 5% RH	
		Überschreitung Floor Life bei < 72 h"	Überschreitung Floor Life bei > 72 h"	Überschreitung Floor Life bei < 72 h"	Überschreitung Floor Life bei > 72 h"	Überschreitung Floor Life bei < 72 h"	Überschreitung Floor Life bei > 72 h"	Überschreitung Floor Life bei < 72 h"	Überschreitung Floor Life bei > 72 h"
		<i>XSD serie</i>		<i>XSDB / HSD / MSD series</i>		<i>SD+/SD/SDB/ESDA series</i>		<i>SD+/SD/SDB/ESDA series</i>	
Gehäusekörper < 0.5 mm (siehe Anm. 4)*	2	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)
	2a	1 Std.	1 Std.	3 Std.	2 Std.	9 Std.	6 Std.	12 Std.	8 Std.
	3	1 Std.	1 Std.	6 Std.	2 Std.	18 Std.	6 Std.	22 Std.	8 Std.
	4	1 Std.	1 Std.	6 Std.	2 Std.	18 Std.	6 Std.	22 Std.	8 Std.
	5	1 Std.	1 Std.	6 Std.	2 Std.	18 Std.	6 Std.	23 Std.	8 Std.
	5a	2 Std.	1 Std.	7 Std.	2 Std.	21 Std.	6 Std.	26 Std.	8 Std.
Gehäusekörper > 0.5 mm ≤ 0.8 mm (siehe Anm. 4)*	2	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)
	2s	6 Std.	5 Std.	1 Tage	18 Std.	3 Tage	2 Tage	4 Tage	3 Tage
	3	6 Std.	5 Std.	1 Tage	18 Std.	3 Tage	2 Tage	4 Tage	3 Tage
	4	6 Std.	5 Std.	1 Tage	18 Std.	3 Tage	2 Tage	4 Tage	3 Tage
	5	6 Std.	5 Std.	1 Tage	18 Std.	3 Tage	2 Tage	4 Tage	3 Tage
	5a	6 Std.	5 Std.	1 Tage	18 Std.	3 Tage	2 Tage	4 Tage	3 Tage
Gehäusekörper > 0.8 mm ≤ 1.4 mm (siehe Anm. 4)*	2	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)	Nicht notwendig (siehe Anm. 3)
	2a	12 Std.	11 Std.	2 Tage	2 Tage	6 Tage	5 Tage	8 Tage	7 Tage
	3	12 Std.	11 Std.	2 Tage	2 Tage	6 Tage	5 Tage	8 Tage	7 Tage
	4	15 Std.	11 Std.	3 Tage	2 Tage	9 Tage	6 Tage	10 Tage	7 Tage
	5	17 Std.	11 Std.	3 Tage	2 Tage	9 Tage	6 Tage	11 Tage	7 Tage
	5a	18 Std.	11 Std.	3 Tage	2 Tage	9 Tage	6 Tage	12 Tage	7 Tage
Gehäusekörper > 1.4 mm ≤ 2.0 mm (siehe Anm. 4)*	2	38 Std.	30 Std.	6 Tage	5 Tage	18 Tage	15 Tage	25 Tage	20 Tage
	2a	2 Tage	33 Std.	7 Tage	6 Tage	21 Tage	18 Tage	29 Tage	22 Tage
	3	2 Tage	33 Std.	9 Tage	6 Tage	27 Tage	20 Tage	37 Tage	23 Tage
	4	3 Tagae	2 Tage	12 Tage	7 Tage	36 Tage	22 Tage	47 Tage	28 Tage
	5	4 Tage	3 Tage	14 Tage	9 Tage	42 Tage	27 Tage	57 Tage	35 Tage
	5a	5 Tage	4 Tage	20 Tage	14 Tage	60 Tage	42 Tage	79 Tage	56 Tage
Gehäusekörper > 2.0 mm ≤ 4.5 mm (siehe Anm. 4)*	2	5 Tage	4 Tage	20 Tage	17 Tage	60 Tage	50 Tage	79 Tage	67 Tage
	2a	5 Tage	4 Tage	20 Tage	17 Tage	60 Tage	50 Tage	79 Tage	67 Tage
	3	5 Tage	4 Tage	20 Tage	17 Tage	60 Tage	50 Tage	79 Tage	67 Tage
	4	5 Tage	4 Tage	20 Tage	17 Tage	60 Tage	50 Tage	79 Tage	67 Tage
	5	5 Tage	4 Tage	20 Tage	17 Tage	60 Tage	50 Tage	79 Tage	67 Tage
	5a	5 Tage	4 Tage	20 Tage	17 Tage	60 Tage	50 Tage	79 Tage	67 Tage
Ausnahme für BGA-Gehäuse > 17 mm x 17 mm oder jedes gestapelte Die-Gehäuse	2-5a	64 Tage (siehe Anm. 2 und Anm. 4)	Siehe oben entsprechend Gehäusedicke und Feuchtigkeits- klasse	Nicht anwendbar	Siehe oben entsprechend Gehäusedicke und Feuchtigkeits- klasse	Nicht anwendbar	Siehe oben entsprechend Gehäusedicke und Feuchtigkeits- klasse	Nicht anwendbar	Siehe oben entsprechend Gehäusedicke und Feuchtigkeits- klasse

Anmerkung 1: Die Tabelle beruht auf den ungünstigen SMD-Leadframe-Plastikgehäusen. Der Anwender kann, soweit technisch gerechtfertigt, die tatsächlichen Temperzeiten reduzieren (z.B. Absorptions-/Desorptionsdaten etc.). In den meisten Fällen kann es auf andere, nicht hermische SMD-Gehäuse angewendet werden.

Anmerkung 2: Bei BGA-Gehäusen > 17 mm x 17 mm, die keine inneren Lagen haben, die die Feuchtigkeitsdiffusion im Substrat blockieren, können Temperzeiten auf Basis der Gehäusedicke/Feuchtigkeitsklasse in der Tabelle ausgewählt werden.

Anmerkung 3: Keine Trocknung erforderlich, wenn die Floorlifezeit von < 30°C & < 60%RH nicht überschritten ist für dünne (< 1,4 mm) MSL2-Bauteile. Dies gilt aufgrund des Feuchtigkeitsdiffusionsverhaltens von dünnen Bauteilen, die aufgrund ihres Absorptionverhaltens bei MSL 2 (168 Std. bei 85°C/60%RH) vollständig gesättigt sind.

Anmerkung 4: Die angegebenen Trocknungszeiten sind konservative Annahmen für Packages ohne Schutzgehäuse oder Stacked Die. Für BGA-Gehäuse mit inneren Lagen, die die Feuchtigkeitsdiffusion blockieren und Stacked Die, können die tatsächlichen Trocknungszeiten von der Tabelle abweichen.